华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

（2026 年 8 月）

证券简称：华润微 证券代码：688396

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	08 月 25 日 国联民生证券 中信建投证券 国信证券 华泰证券 长江证券 申万宏源证券 广发证券 国泰海通证券 国海证券 银河证券 华福证券 山西证券 爱建证券 中信证券 开源证券 中银国际证券 德邦证券 太平洋证券 长城证券 光大证券 方正证券 东吴证券 天风证券 兴业证券 平安证券 华源证券 浙商证券

	财通证券	瑞银证券	上海涌铧投资
	美银证券	花旗环球金融	野村国际证券
	浙江秘银投资	中信保诚基金	中信建投基金
	中欧基金	中邮创业基金	中银基金
	九泰基金	交银施罗德基金	兴业基金
	兴华基金	农银汇理基金	创金合信基金
	华宝基金	华泰保兴基金	南华基金
	南方基金	博时基金	嘉实基金
	国泰基金	国联基金	圆信永丰基金
	宝盈基金	富国基金	富安达基金
	富荣基金	平安基金	新华基金
	景顺长城基金	永赢基金	汇丰晋信基金
	泓德基金	浙商基金	浦银安盛基金
	海富通基金	申万菱信基金	睿远基金
	红塔红土基金	融通基金	西部利得基金
	诺安基金	鑫元基金	银河基金
	上海理成资产	红骅投资	鸿运私募
	长信基金	泰康资产	中国人保资产
	太平养老保险	英大资产	中国人寿养老保险
	平安资产	中国人寿资产	众安在线财产保险
	招银理财	建信理财	淡水泉（北京）投资

	国君资产	东吴人寿保险	深圳市伯利恒资产
	工银资产	平安养老保险	上海汐泰投资
	宁银理财	招商信诺资产	航长投资
	光大永明资产	上海高毅资产	西安敦成私募
	路博迈基金	深圳抱朴资产	上海利位私募
	珠海市聚隆私募	杭州科策投资	浙江慧远投资
	上海熵盈私募	杭州玖龙资产	上海盈怀私募
	武汉证国私募	深圳市银桦投资	太保资管
	浙江象舆行投资	深圳鑫然投资	友邦保险
	上海和谕私募	红思客资产	佛山市东盈投资
	广州市乾元资产	上海大筝资产	摩根大通资产管理
	海南鸿运私募	天阔私募	江岳私募
	上海益和源资产	上海博笃投资	联创永圆股权投资
	合众资产管理	国新投资	宁波信石投资
	江苏瑞华投资	上海聆泽投资	深圳华强鼎信投资
	上海煜德投资	上海尚颀投资	上海景林资产
	国泰海通资管	吕梁小金地资产	宁波幻方量化投资
	国泰君安资产	京鑫翰资本	上海筌笠资产
	厦门坤易投资	华夏久盈资产	北京诚盛投资
	宏恩资产	度势投资	米仓资本
	厦门中略投资	长见投资	华泰证券资产

	兴业证券资产　光大证券资产　中信建投证券资产 长城证券资产　方正证券资产　申万宏源证券资产 天风证券资产　平安证券资产　上海复胜资产 东吴证券资产　Trivest Advisors　Enreal Asset Manulife　Point72　Pinpoint Keywise Capital　Maybank　Mount Everest Fund T. Rowe Price　Jarislowsky　GIC 狮城产业投资 Cephei Capital　Balyasny Asset　Drummond Knight Asset Nature Capital　Baring Asset 08 月 26 日 国信证券、光大证券、宝盈基金、鹏华基金、南方基金、博时基金、长城基金、景顺长城基金、摩根士丹利基金 08 月 27 日 国信证券、光大证券、富国基金、平安基金、T. Rowe Price、信达澳亚基金、诚旸投资 08 月 28 日 华福证券、申万菱信基金、汐泰投资、农银汇理基金、太平养老、瓴仁投资、圆信永丰基金、南方基金、建信基金、金元证券
时间	08 月 25 日、08 月 26 日、08 月 27 日、08 月 28 日
地点	无锡、深圳、上海

上市公司接待人员姓名	何小龙　华润微电子董事长 吴国屹　华润微电子董事、财务总监兼董秘 沈筛英　华润微电子董事会办公室主任
投资者关系活动主要内容介绍	**问题一：请问公司如何看待行业景气度的持续性？** 答：综合半导体行业应用趋势、客户需求变化以及供需匹配情况，我们判断行业景气度将进入上行长周期。从应用与发展趋势看，AI 正深度赋能自动驾驶、具身智能、智能终端、算力基础设施等关键场景，带动功率、模拟及数模混合等半导体需求快速增长，为行业提供持续动能。从供需匹配看，尽管需求旺盛，但行业新增产能释放相对有限，扩产节奏已进入有序可控阶段；同时，新项目从建设到达产需要一定周期，与当前旺盛的需求相比仍存在时间差，供需缺口预计将持续扩大。从客户需求看，下游客户不再单纯以价格作为采购的唯一考量，更加看重供应的稳定性、交付能力及产品可靠性，这反映客户对长期合作与质量保障的重视，也使得公司更有能力承接战略性大客户订单。综上，多重因素共振下，行业景气度具备较强的持续性和向上的动能。 **问题二：请问公司在 MEMS 传感器领域的布局及长期成长空间？** 答：传感器与光芯片是公司未来五年布局的第三条增长曲线，战略优先级明确。公司重点围绕 MEMS、光传感、CIS、视觉传感及

	光芯片等方向展开布局，主要面向光通信、机器人、智能驾驶及边缘计算等高增长场景。技术层面，公司在 MEMS 成熟特色工艺领域积淀深厚，能够为产品提供坚实的制造能力支撑；产品层面，内部自研和市场拓展同步推进，同时已储备多个合作项目及外延标的，为公司未来发展打开了成长空间。 **问题三：请问公司毛利率的变化趋势及提升的具体路径？** 答：公司毛利率提升主要有三条路径：一是通过产品涨价直接推动，受益于上半年两轮调价，二季度毛利率环比改善趋势已开始显现；二是持续优化产品结构，在订单饱满的情况下，将有限资源优先投向高附加值、高毛利产品，主动缩减低毛利业务比重；三是长期推进降本增效，通过成本管控和费用优化，从成本端改善毛利率水平。 **问题四：请公司梳理今年以来涨价及落地情况，后续如何判断涨价节奏？** 答：受在手订单饱满、产能供给偏紧影响，公司分别于 2 月、7 月实施两轮产品调价，其中第二轮调价谈判已在 7 月基本完成，涨幅及覆盖范围较第一轮均有明显提升。由于订单交付周期影响，报表端体现会有一定滞后性，预计三季度涨价带来的利好效应将进一步显现。下半年市场供需预计仍将偏紧，公司在手订单饱满，

	对后续产品定价保持积极态势。 **问题五：请问公司代工业务中 BCD 特色工艺需求以及涨价情况？** 答：公司 BCD 工艺广泛覆盖 1.8V 至 1200V 全电压等级，是公司极具特色和竞争力的技术平台。上半年 BCD 客户需求饱满，产能供不应求，公司已针对不同客户实施多轮调价，毛利率水平得到进一步提升。下半年，公司将根据市场供需和自身订单情况制定合理的调价方案。同时，考虑到下半年原材料硅片成本有所增长，公司也将进行价格传导。 **问题六：请问公司是否有扩产计划？部分设备材料供应趋紧，公司如何应对？** 答：为应对当前饱满的市场需求，公司正进行适度产能扩充。6 吋、8 吋产线主要通过技改实现小幅提升；两条 12 吋产线利用现有空余洁净厂房，通过添置设备进行扩产，新增产能预计明年陆续释放。 原材料端，上半年部分特殊气体供应紧张，公司强化与国内供应链的深度绑定，积极导入国产供应商，以平滑短期波动，目前原材料供应风险总体可控。 设备端，公司持续推进国产设备的验证与导入，虽然整体设备交期有所拉长，但由于前期已积极引入国产替代方案，目前仍在可

	控范围内，符合公司预期。 **问题七：请问公司碳化硅业务增速快、毛利率好的原因，以及后期的产能扩充计划?** 答：碳化硅业务上半年营收同比实现翻番以上增长，业务结构持续优化，其中汽车和储能终端收入占比合计达 85%。由于公司碳化硅与硅基产线并行，成本相对可控，叠加近年来碳化硅材料价格下降明显，毛利率逐步改善，尤其是 SiC MOS 产品毛利率表现更优。在产能方面，公司自有 SiC 产能有限，正积极寻求外协产能，与外部供应商深度合作。后期计划通过投资并购、参股等方式锁定产能，以承接客户订单、满足市场需求。总体而言，公司将通过自建与外延合作相结合的方式，进一步扩充碳化硅产能。 **问题八：请问公司对于 AI 服务器数据中心发展的预期?** **答：**公司在数据中心电源领域已经形成了完整的产品矩阵，覆盖 DrMOS 功率模块、多相控制器、板级 POL、硅基及第三代半导体功率器件、驱动及控制芯片等关键环节。在供电架构上，已完整布局从一级供电（PSU/HVDC/SST 架构）、二级 IBC 到三级板级电源的全链路方案，可提供“功率器件+驱动+控制+模块”的一体化方式交付方案。当前硅基及三代半产品已实现上量，并成功导入主流电源厂商及云端客户。据行业数据，2026 年国内数据中心市

	场规模约 2800 亿元，2030 年有望突破 5000 亿元，复合增速超过 15%，功率半导体等产品应用空间广阔，增长可期。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月